

## FPC PCB Technics Capacity

No.	項目	説明	データシード
1	FPC 主材料	ブランド	タイフレックス、グラセス）、SY
2	PCB材料	ブランド	SY、ITEQ、KB
3	テクスチャー	テクスチャーブランド	PI、PET
4	カバーフィルム	ブランド	タイフレックス、グラセス、SY
5	最大層数	レイヤー	1~14層（サンプル）、1~12層（製造）
6	仕上げ板厚	mm	0.25-6.0mm（サンプル） リジッド-フレックスPCB 0.25-6.0mm
7	最小パターン幅/間隔	mm	0.05mm/0.05mm
8	最大仕上げボードサイズ	mm	230*450mm
9	仕上げ板厚許容差	mm	±50.05mm
10	PP厚さ	mm	12.5um、25um、50um
11	銅の厚さ	mm	12um、18um、36um、70um
12	補強材	品種	FR4、PI、PET、SUS、PSA
13	表面処理	品種	ENIG、無電解スズ、OSP、無電解銀、金メッキ
14	最小穴サイズ	mm	メカニカルホール：0.15mm、レーザーホール：0.1mm
15	穴の許容差	mm	NPTH: ±0.05mm、PTH: ±0.075mm
16	カバーフィルムの色	品種	黄、黒
17	PI厚さ	ミル	0.5ミリ、0.7ミリ、0.8ミリ、1ミリ、2ミリ

## FPC PCB Technics Capacity

18	FPCB最大層数		1-8層
19	最小仕上がりサイズ	mm	5mm*8mm
20	最小パッド	mm	内層（5mil）、外層（4mil）
21	補強材最小サイズ	mm	4mm×5mm
22	スティフナー最大サイズ	mm	32mm×32mm
23	スティフナーアライメント精度	mm	±0.075mm
24	カバー最小開口寸法	mm	0.6×0.6mm(スチール金型)、0.5×0.5mm(精密金型)
25	カバーフィルム最小開口間隔	mm	0.5mm（精密加工）、0.2mm（レーザー加工）、0.15mm（通常穴あけ加工）
26	被覆フィルムのはみ出し量（片側）	mm	通常0.08～0.12mm、限界0.03mm
27	ゴールドフィンガー半円穴最小径	mm	0.25mm，通常値0.3mm
28	リジッドフレックス基板：剥離強度	N	1.4N
29	リジッドフレックス基板：平面度	mm	焼成前15μm以下，焼成後30μm以下
30	リジッドフレックスプリント基板：熱衝撃	℃	288℃（10秒以内3回）
31	リジッドフレックスプリント基板：W/B金線引張強度	g	> 6g
32	リジッドフレックスプリント基板：最小板厚	mm	FPCB0.1mm、4層0.3mm、6層0.5mm、10層0.8mm